

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2026-0923-039

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                        |
| 参与单位名称            | 万家基金、东方证券、中泰证券（参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 时间                | 2026 年 9 月 23 日 10:00-11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点                | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 形式                | 实地调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司接待<br>人员姓名      | 钱元君、马明慧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动<br>主要内容介绍 | <p>一、2026 年上半年公司经营业绩</p> <p>公司已披露 2026 年半年度报告，受益于高速交换机、AI 服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，2026 年上半年公司营业收入约 136.89 亿，较同期增长约 61.17%，净利润约 29.23 亿较上年同期增长约 73.72%；公司泰国子公司亦已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营期，并于 2026 年第二季度实现单季扭亏为盈；2026 年上半年汇兑损失约 2.76 亿元。</p> <p>二、数据通讯市场情况</p> <p>2026 年上半年公司数据通讯应用领域 PCB 持续成长，实现营业收入约 113.30 亿元，同比大幅增长约 73.46%，产品结构的持续优化，带动数据通讯应用领域 PCB 毛利率同比增加约 4.60 个百分点。其中：高速网络交换机及其配套路由应用领域实现营业收入约 71.39 亿元；AI 服务器和 HPC 应用领域实</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>现营业收入约 18.28 亿元；通用服务器应用领域实现营业收入约 20.46 亿元；无线通讯网络及其他应用领域实现营业收入约 3.18 亿元。</p> <p>公司持续深耕数据通讯领域底层基础技术攻关，重点围绕超高层堆栈架构、新材料、高密度互连技术等方向开展前置研究，以增强技术储备的广度与深度，应对信号完整性、电源完整性、长期可靠性等方面的技术挑战。并与国内外多家生态伙伴深度协同，前瞻预研下一代平台技术。在算力产品领域，公司围绕各类超节点架构，统筹推进计算、交换、互连方向核心技术攻关及产品落地，适配 224Gbps 传输速率的核心产品已实现小批量供货，并启动支持 448Gbps 传输速率的产品预研；在高速网络交换机方面，应用于 1.6T 交换机的产品已实现批量出货，并推进 3.2T 交换机配套的产品预研。</p> <p>随着行业产能的持续扩张，新增产能的逐步落地，成熟技术平台的准入门槛将被摊薄，未来的竞争或将趋向同质化与白热化。公司历来不盲从于以规模 and 价格为导向的同质化扩张，而是全面深化差异化产品竞争战略，恪守“技术优先”的发展方针。公司深知，唯有技术突破才能跨越周期。公司深度锁定客户技术演进规划，努力将前沿技术的不确定性转化为可控的工程化实践，将研发端的技术前瞻性与制造端的大规模量产能力深度耦合，将优势资源倾斜于数据通讯应用领域高阶硬件所需的高附加值核心 PCB 产品，凭借卓越的创新能力、稳定可靠的品质口碑、国内和泰国的产能协同，与头部客户群体构筑深度的价值共同体，以期在激烈的市场重构中持续提升竞争力，在复杂多变的市场环境中锚定确定性，以求可持续高质量发展。</p> <p><b>三、全面统筹并稳步推进国内外产能的有序扩张与前瞻布局</b></p> <p>1、公司在各生产基地持续推进针对性技改，提升现有产能效率与技术能力；并统筹规划多个新建项目，通过分阶段、节奏化的“升级式”扩容，动态抢抓行业结构性增长机遇。公司旨在通过产能与技术规格的双重跃升，精准响应全球客户对高阶硬件性能跃迁的核心诉求，深度锚定数据通讯领域客户在人工智能、高速数据中心及网络基础设施等场景下，对高性能、高信赖性印制电路板的中长期增量需求。</p> <p>公司在泰国全力推动生产基地从产能爬坡期全面迈入高效规模化运营期。通过着力强化国内外各生产基地的资源协同效应，逐步构建起多维一体、梯次有序的国内外产能梯次矩阵，有效化解地缘政治与供应链重构的潜在风险，为公司长期高质量发展编织牢固的国内外生产供应网络。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>2、在供应链保障端，围绕供应链安全与韧性建设，公司主动深化与供应链伙伴的协同创新机制。在前端，于终端客户研发极早期全面介入，提前参与新材料性能验证与测试，缩短认证周期并锁定优先配额；在后端，全面落实关键物料战略安全库存，并加速推进多元化与本地化认证，有效降低断供风险，筑牢极具韧性的供应链安全屏障。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否                                                                                                                                                            |
| 附件清单                 | 无                                                                                                                                                            |